(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202076245 U
(45)授权公告日 2011.12.14

(21)申请号 201120208162.6

(22)申请日 2011.06.07

(73)专利权人 河南鸿昌电子有限公司
地址 461500 河南省长葛市魏武大道河南鸿昌电子有限公司

(72)发明人 陈建民 陈建卫 陈磊

(51)Int.Cl.
H01L 23/13(2006.01)

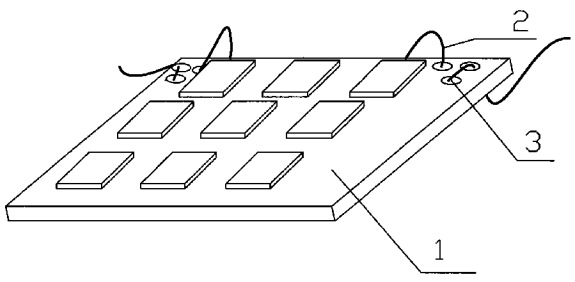
权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

基板具有导线加持槽的半导体块

(57)摘要

本实用新型涉及半导体块。基板具有导线加持槽的半导体块，包括基板和导线，其特征是：所述的基板的周围具有多个开口，所述的导线其中有一段来回穿插开口。这样的半导体块具有经久耐用、导线在上面不易分离，结构简单的优点。



CN 202076245 U

1. 基板具有导线加持槽的半导体块，包括基板和导线，其特征是：所述的基板的周围具有多个开口，所述的导线其中有一段来回穿插开口。

基板具有导线加持槽的半导体块

技术领域

[0001] 本实用新型涉及半导体块。

背景技术

[0002] 半导体块具有基板和上面焊接的多个半导体晶块，还具有半导体晶块连接着的导线，在现有技术中，导线和基板之间没有连接的结构，这样的半导体块和导线之间就容易分离，影响半导体块的正常使用。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目就是针对上述缺点，提供一种经久耐用、导线在上面不易分离的半导体块——基板具有导线加持槽的半导体块。

[0004] 本实用新型所采取的技术方案是这样的：基板具有导线加持槽的半导体块，包括基板和导线，其特征是：所述的基板的周围具有多个开口，所述的导线其中有一段来回穿插开口。

[0005] 本实用新型的有益效果是：这样的半导体块具有经久耐用、导线在上面不易分离，结构简单的优点。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 其中：1、基板 2、导线 3、开口

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0009] 如图 1 所示，基板具有导线加持槽的半导体块，包括基板 1 和导线 2，其特征是：所述的基板 1 的周围具有多个开口 3，所述的导线 2 其中有一段来回穿插开口 3。

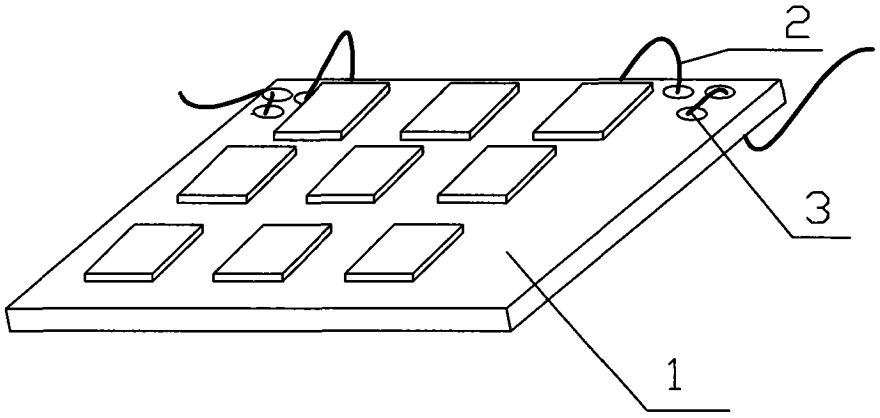


图 1